

2016年3月期 第2四半期（2015年4月～9月） 東京エレクトロン 決算説明会

2015年10月27日

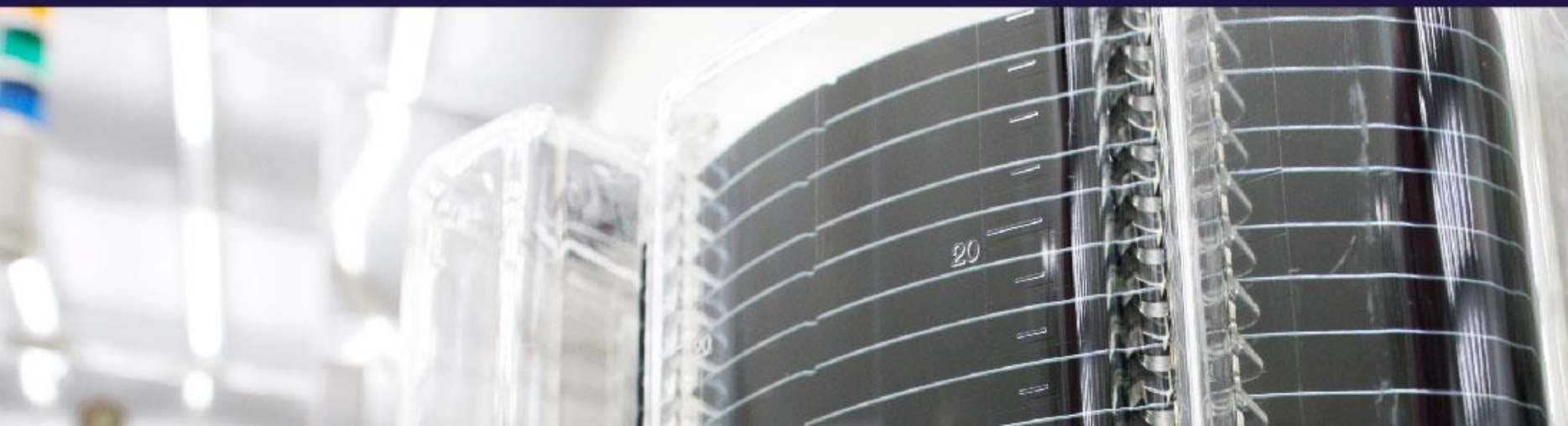
内容：

- 挨拶 代表取締役社長、CEO 東 哲郎
- 第2四半期連結決算の概要 取締役常務執行役員 堀 哲朗
- 当期業績予想および中期経営計画達成に向けた取り組み
代表取締役副社長、COO 河合 利樹

第2四半期連結決算の概要

2015年10月27日

堀 哲朗
取締役常務執行役員



2016年3月期 上期のハイライト

- SPE事業における収益性向上により、2半期連続で過去最高水準の売上総利益率40%を達成
- 営業利益前年同期比2倍、2半期連続で営業利益率18%を達成
- 上期FPDセグメント利益率13%を達成

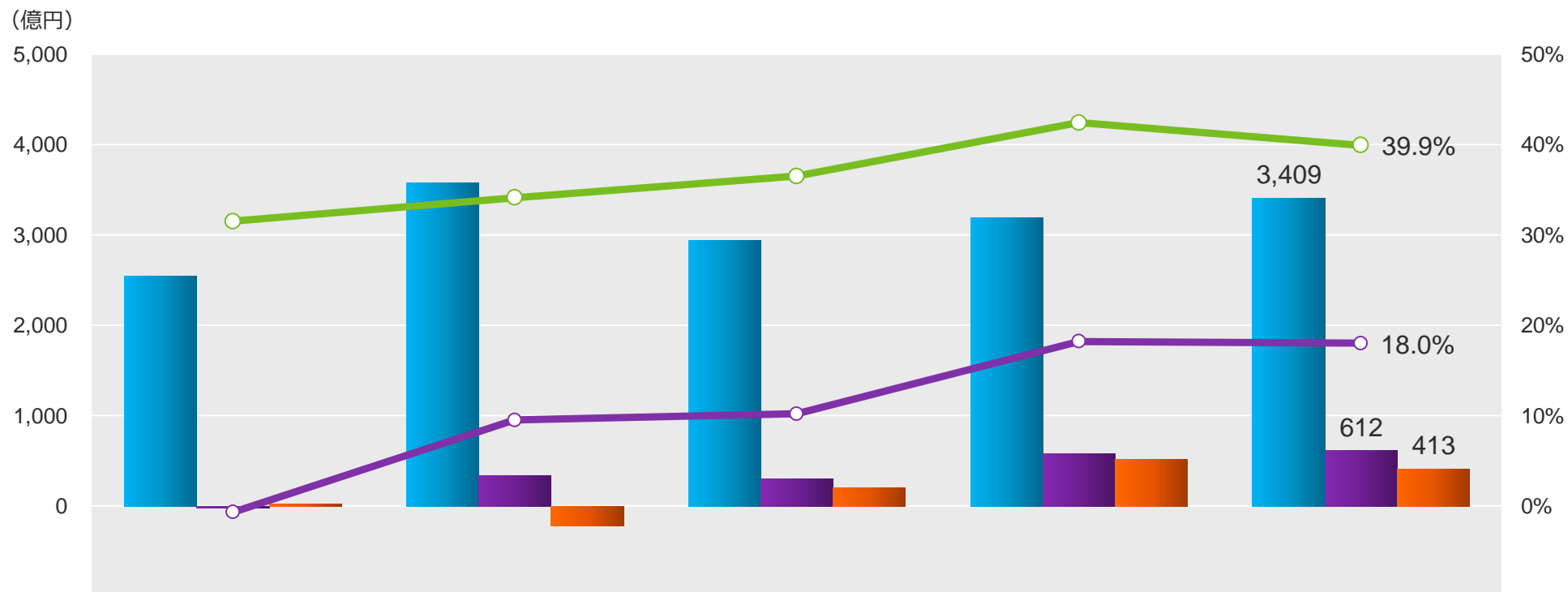
損益状況

(億円)

	2015年3月期		2016年3月期	対前年上期 増減	(ご参考) 7/28発表の 2016年3月期 上期予想
	上期	下期	上期		
売上高	2,942	3,188	3,409	+15.9%	3,385
売上総利益 下段：売上総利益率	1,074 36.5%	1,353 42.4%	1,360 39.9%	+26.6% +3.4pts	
販管費	773	773	747	-3.3%	
営業利益 下段：営業利益率	301 10.2%	579 18.2%	612 18.0%	+103.4% +7.8pts	535 15.8%
税前利益	291	577	575	+97.7%	525
親会社株主に帰属する 当期純利益	200	518	413	+106.7%	370
研究開発費	349	363	375	+7.5%	
設備投資額	72	59	48	-33.4%	
減価償却実施額	97	111	93	-3.7%	

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

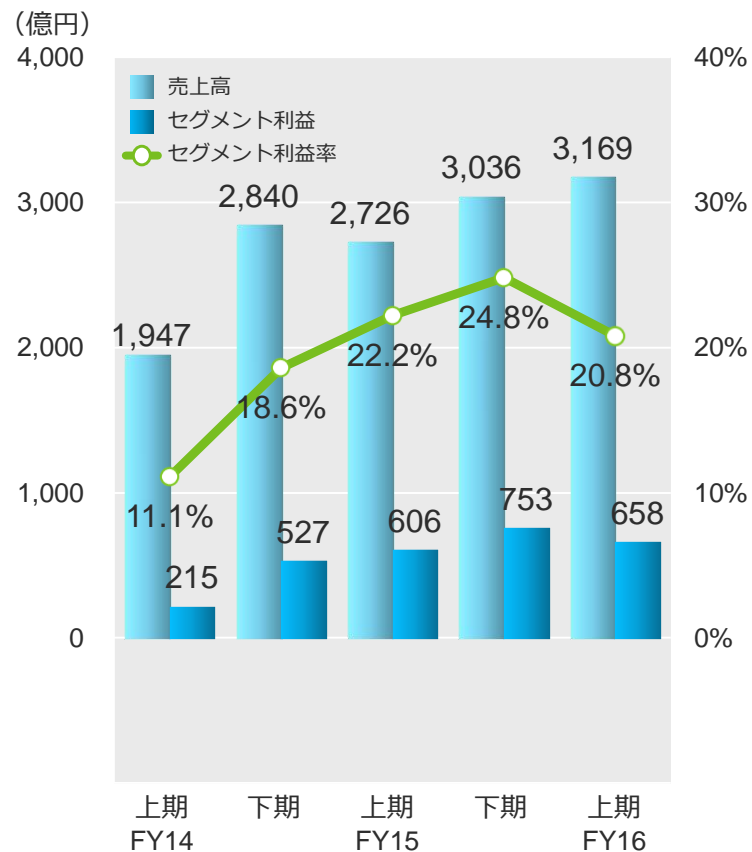
損益状況



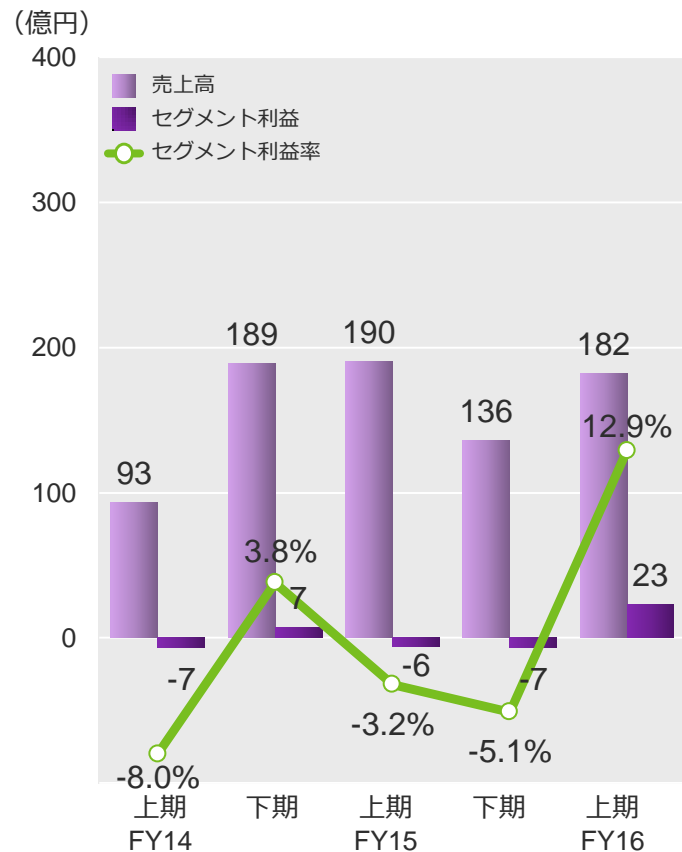
	上期 FY14	下期	上期 FY15	下期	上期 FY16
売上高	2,545	3,576	2,942	3,188	3,409
営業利益	-18	340	301	579	612
親会社株主に帰属する当期純利益	24	-218	200	518	413
売上総利益率	31.5%	34.1%	36.5%	42.4%	39.9%
営業利益率	-0.7%	9.5%	10.2%	18.2%	18.0%

セグメント情報

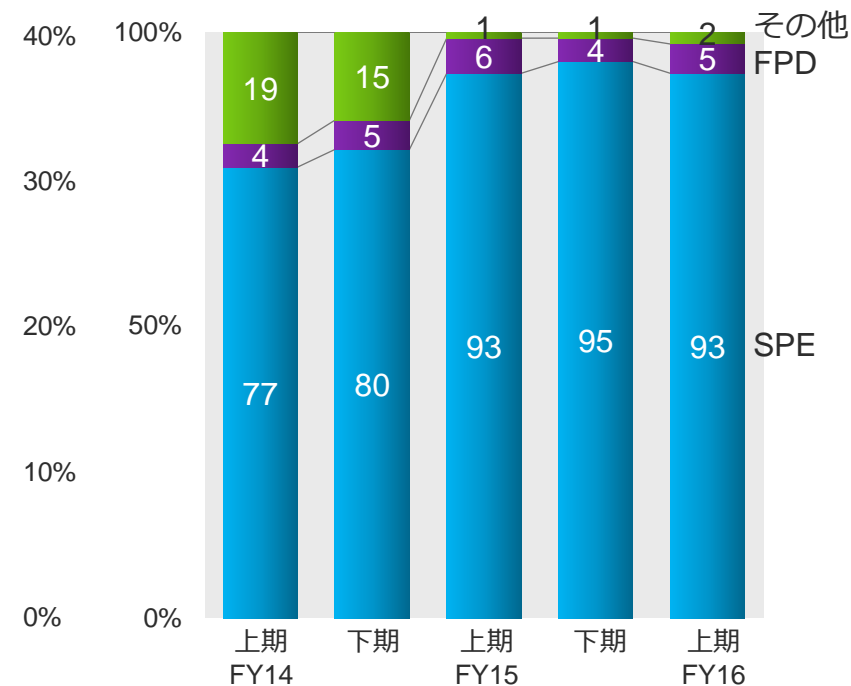
SPE (半導体製造装置)



FPD (FPD製造装置)

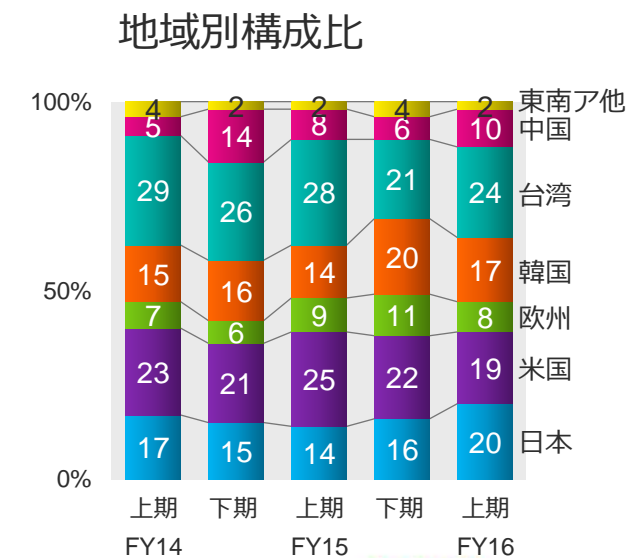
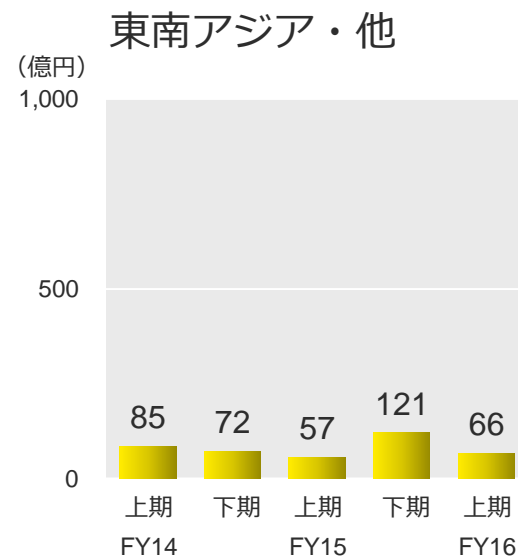
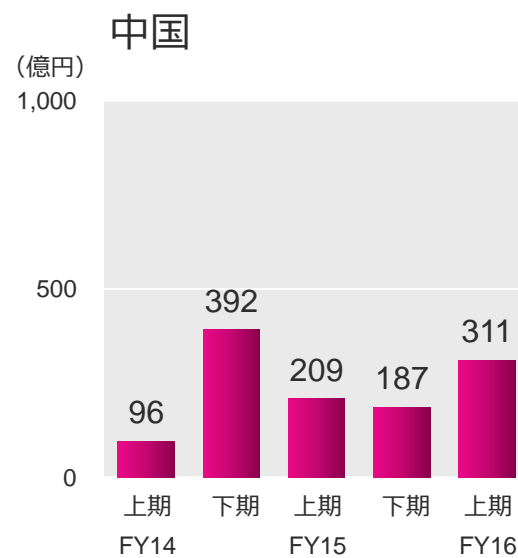
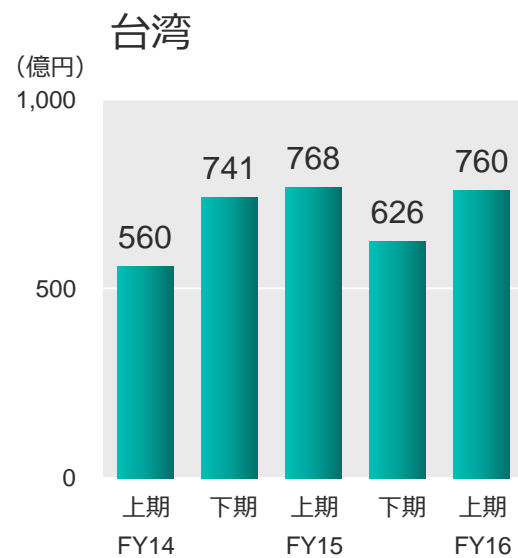
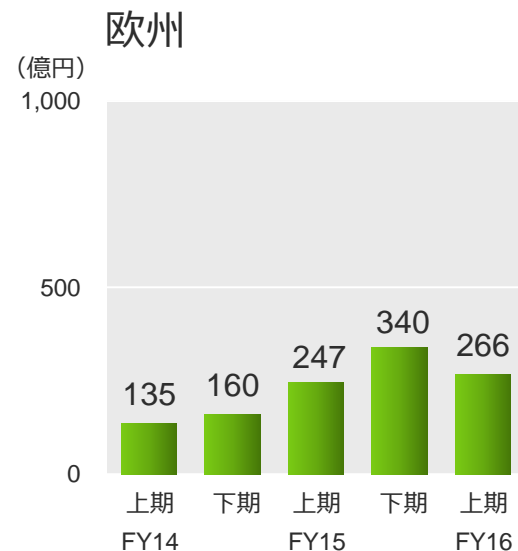
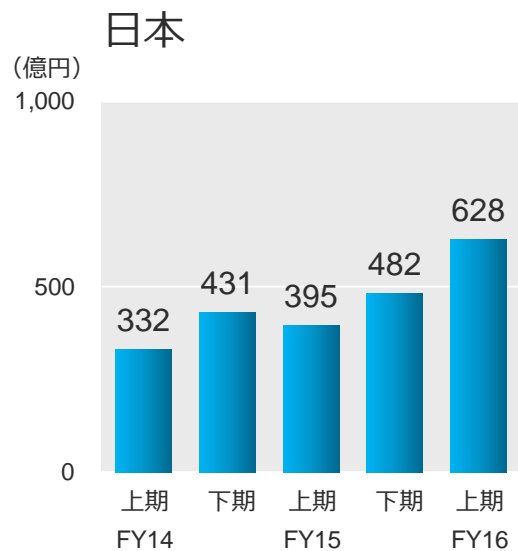


売上構成比率



1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. PV製造装置事業については、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に定める重要性を満たさなくなったため、FY16/1Qより報告セグメントから除外しました。
4. 売上構成比率において、EC/CN事業とPV製造装置事業はその他に含めています。

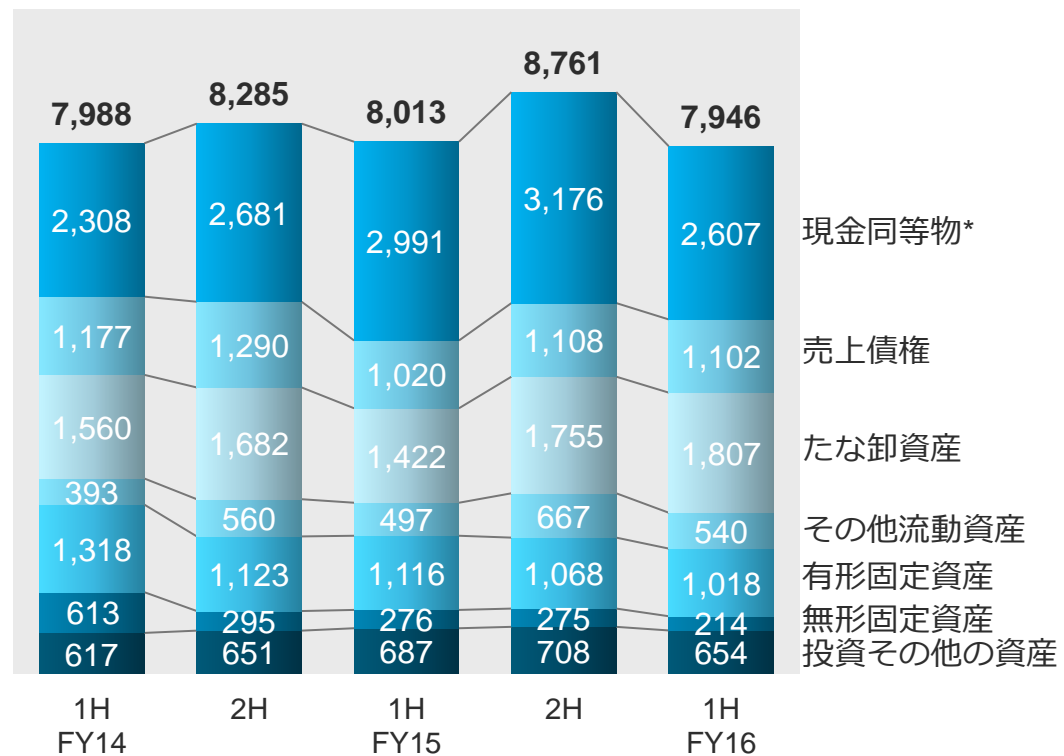
SPE部門地域別売上高



貸借対照表

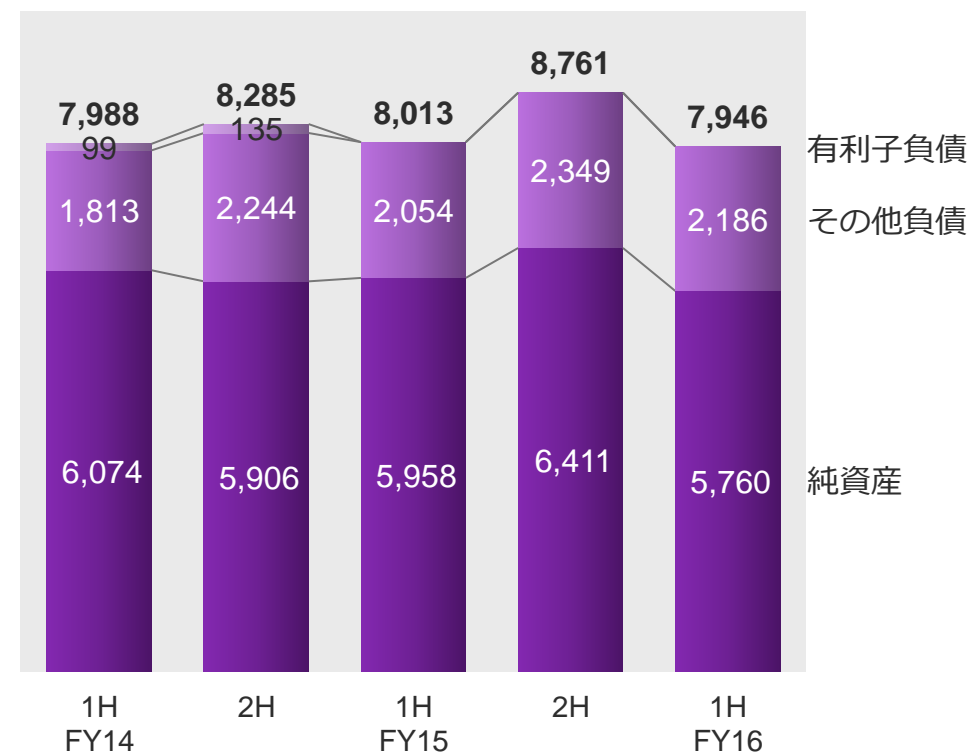
資産

(億円)



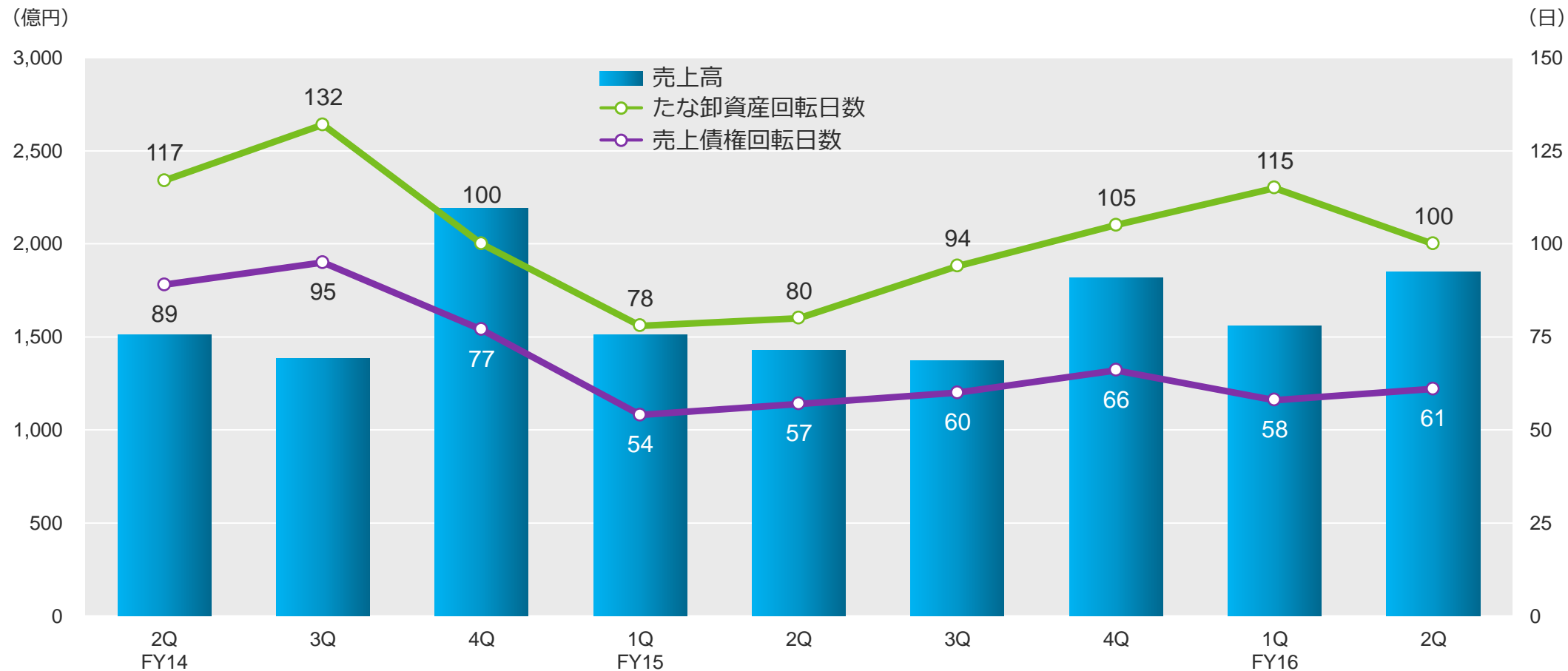
負債・純資産

(億円)



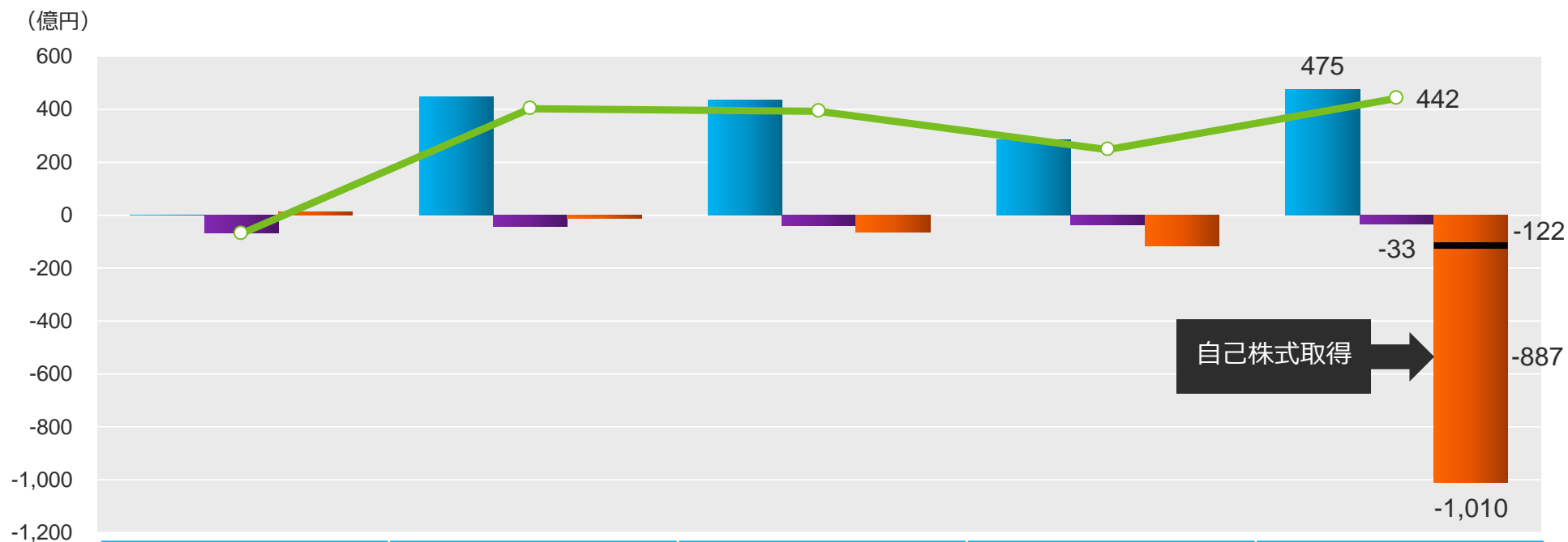
*現金同等物：現預金＋短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー



	上期 FY14	下期	上期 FY15	下期	上期 FY16
■ 営業キャッシュフロー	-2	446	433	284	475
■ 投資キャッシュフロー*	-67	-42	-39	-36	-33
■ 財務キャッシュフロー	11	-12	-64	-117	-1,010
○ フリーキャッシュフロー**	-70	403	393	248	442
手元資金残高***	2,308	2,681	2,991	3,176	2,607

*投資キャッシュフローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

**フリーキャッシュフロー = 営業活動によるキャッシュフロー + 投資活動によるキャッシュフロー (満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く)

***手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

自己株式取得の進捗状況

取得した自己株式の累計 (2015年9月30日現在)

(1) 株式の総数	12,757,600株
(2) 株式の取得価額の総額	88,752,003,369円

2015年4月27日発表内容

- 取得対象株式の種類 : 当社普通株式
- 取得し得る株式の総数 : 1,540万株 (上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 8.59%)
- 株式の取得価額の総額 : 1,200 億円 (上限)
- 取得する期間 : 2015年5月14日～2016年5月13日

補足資料

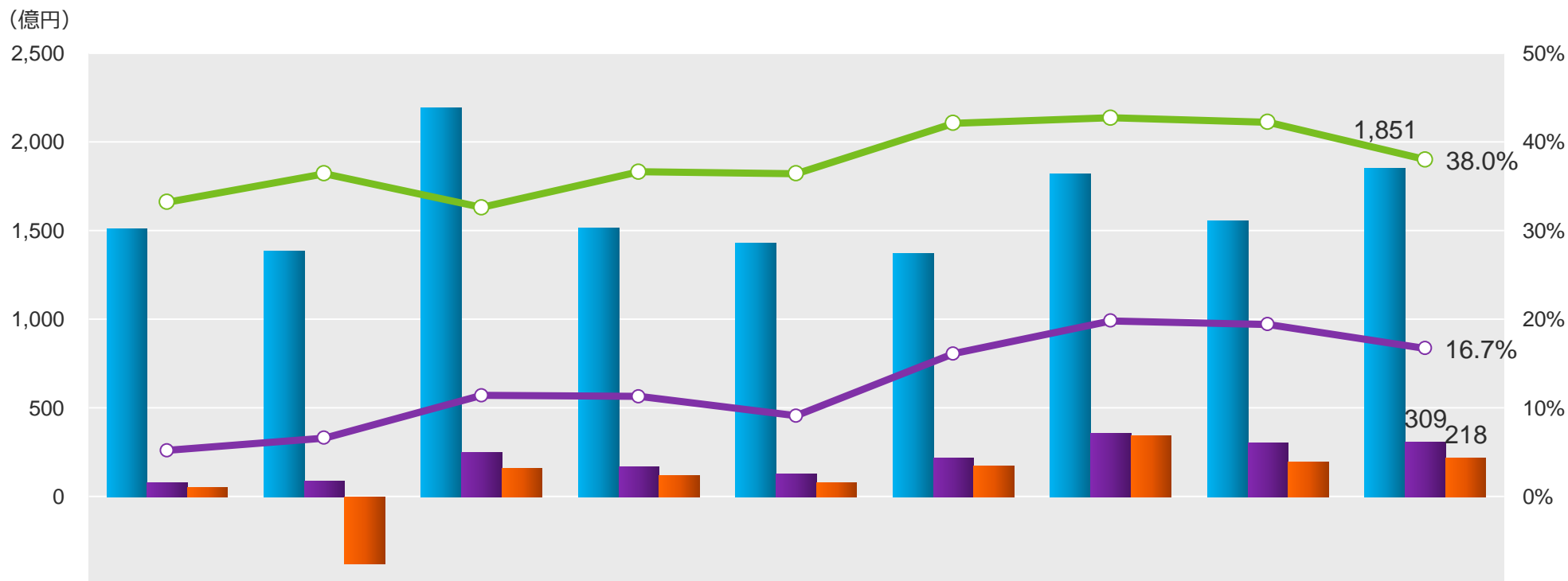
損益状況

(億円)

	2015年3月期			2016年3月期		対前年 2Q増減
	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	
売上高	1,429	1,370	1,818	1,557	1,851	+29.5%
売上総利益 下段：売上総利益率	520 36.4%	576 42.1%	776 42.7%	657 42.2%	703 38.0%	+35.0% +1.6pts
販管費	390	355	417	354	393	+0.8%
営業利益 下段：営業利益率	130 9.1%	220 16.1%	359 19.8%	302 19.4%	309 16.7%	+137.4% +7.6pts
税前利益	140	247	329	290	284	+101.9%
親会社株主に帰属する 当期純利益	81	174	344	194	218	+167.6%
研究開発費	181	168	195	175	200	+9.9%
設備投資額	35	26	32	21	26	-24.7%
減価償却実施額	50	54	56	46	47	-5.3%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

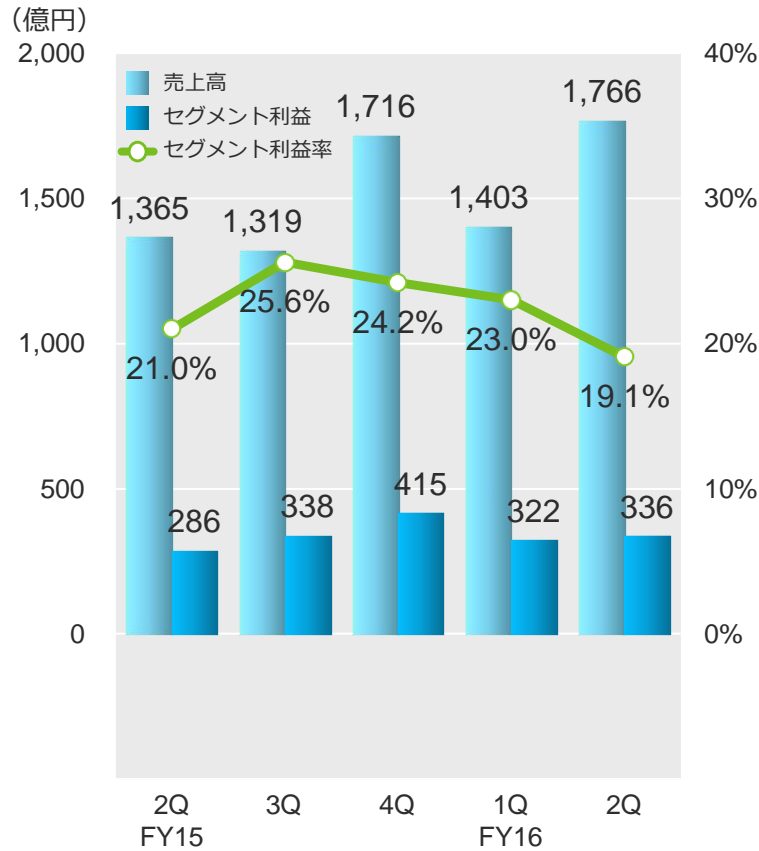
損益状況



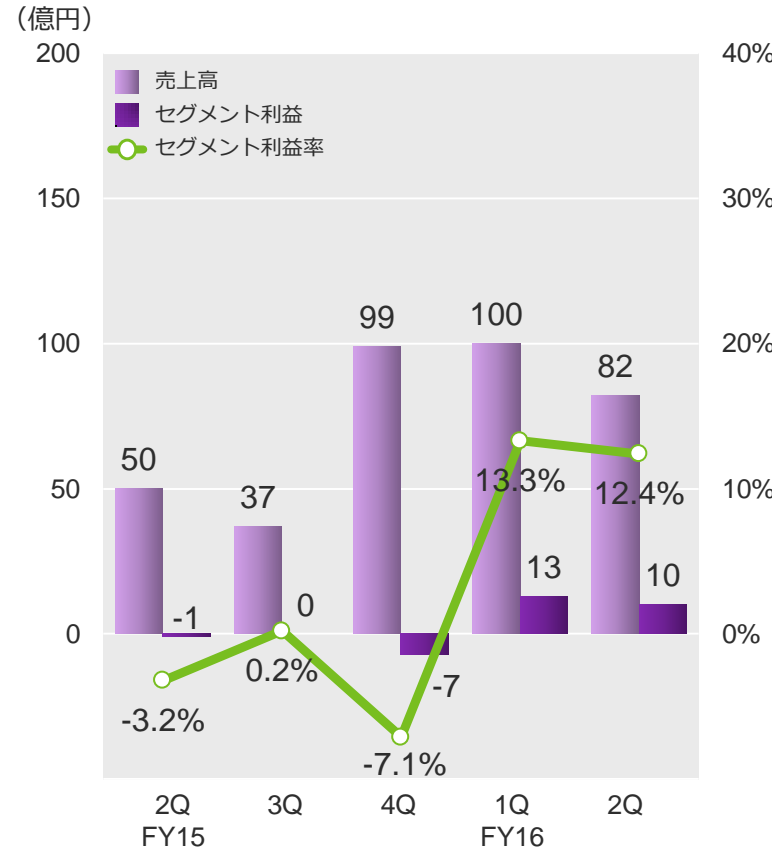
	2Q FY14	3Q	4Q	1Q FY15	2Q	3Q	4Q	1Q FY16	2Q
売上高	1,510	1,384	2,192	1,513	1,429	1,370	1,818	1,557	1,851
営業利益	78	90	249	170	130	220	359	302	309
親会社株主に帰属する当期純利益	54	-380	162	118	81	174	344	194	218
売上総利益率	33.2%	36.4%	32.6%	36.6%	36.4%	42.1%	42.7%	42.2%	38.0%
営業利益率	5.2%	6.6%	11.4%	11.3%	9.1%	16.1%	19.8%	19.4%	16.7%

セグメント情報

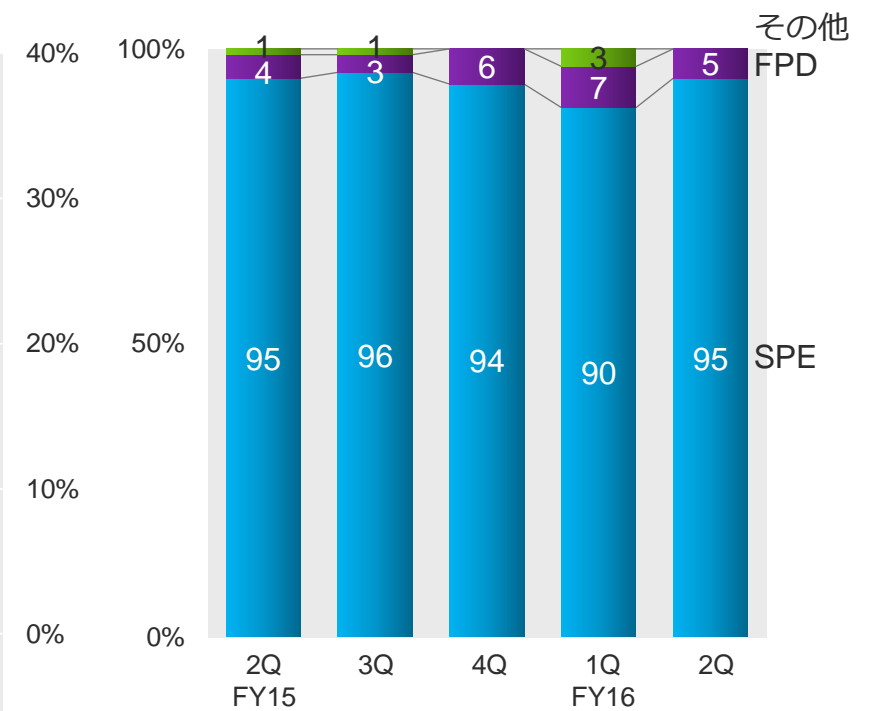
SPE (半導体製造装置)



FPD (FPD製造装置)

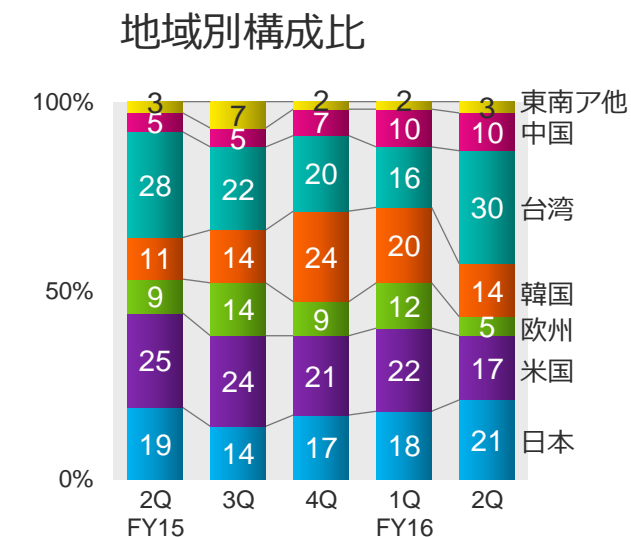
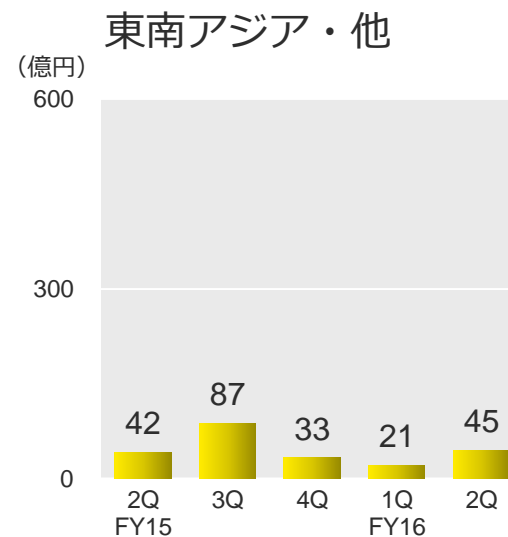
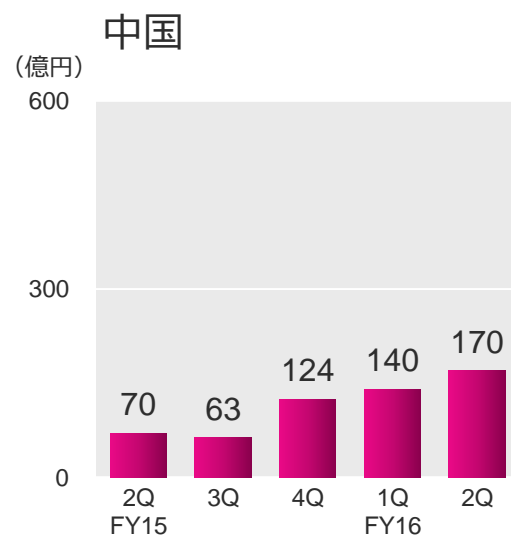
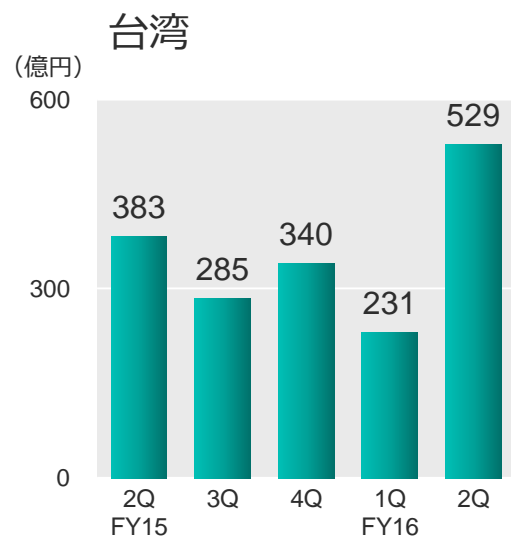
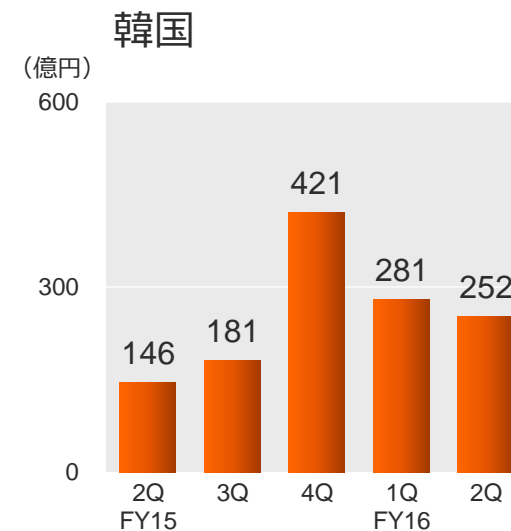
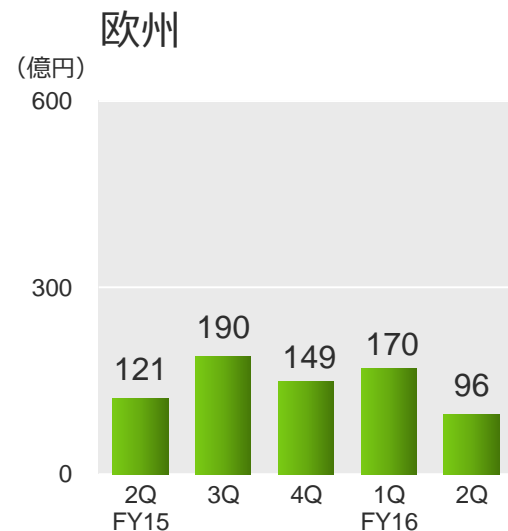
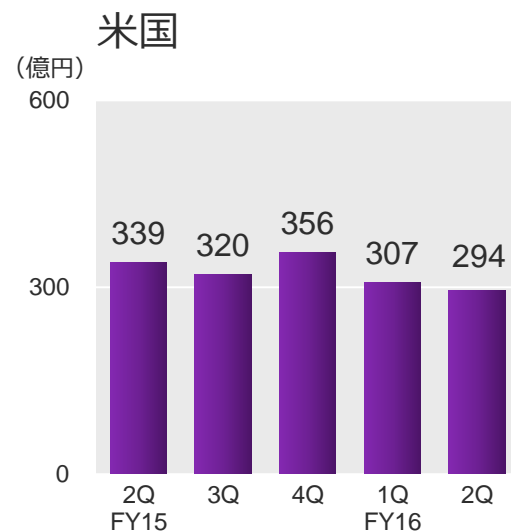
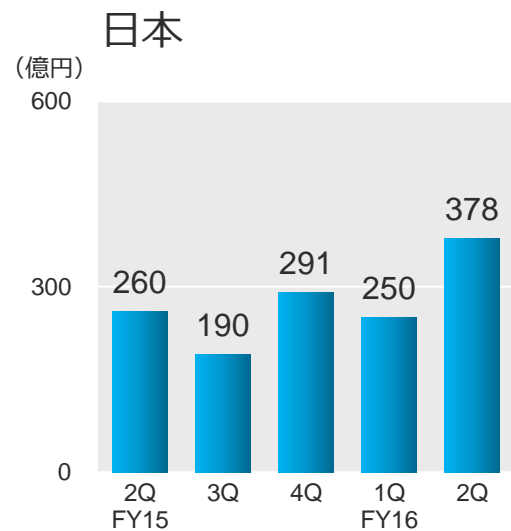


売上構成比率



1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. PV製造装置事業については、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に定める重要性を満たさなくなったため、FY16/1Qより報告セグメントから除外しました。
4. 売上構成比率において、PV製造装置事業はその他に含めています。

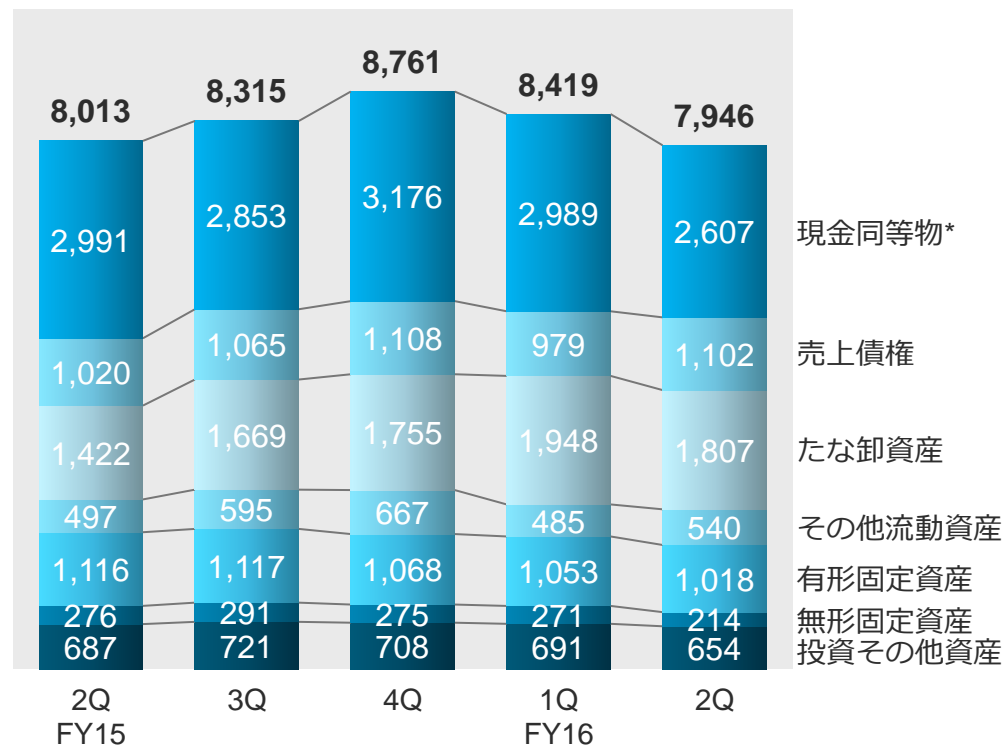
SPE部門地域別売上高



貸借対照表

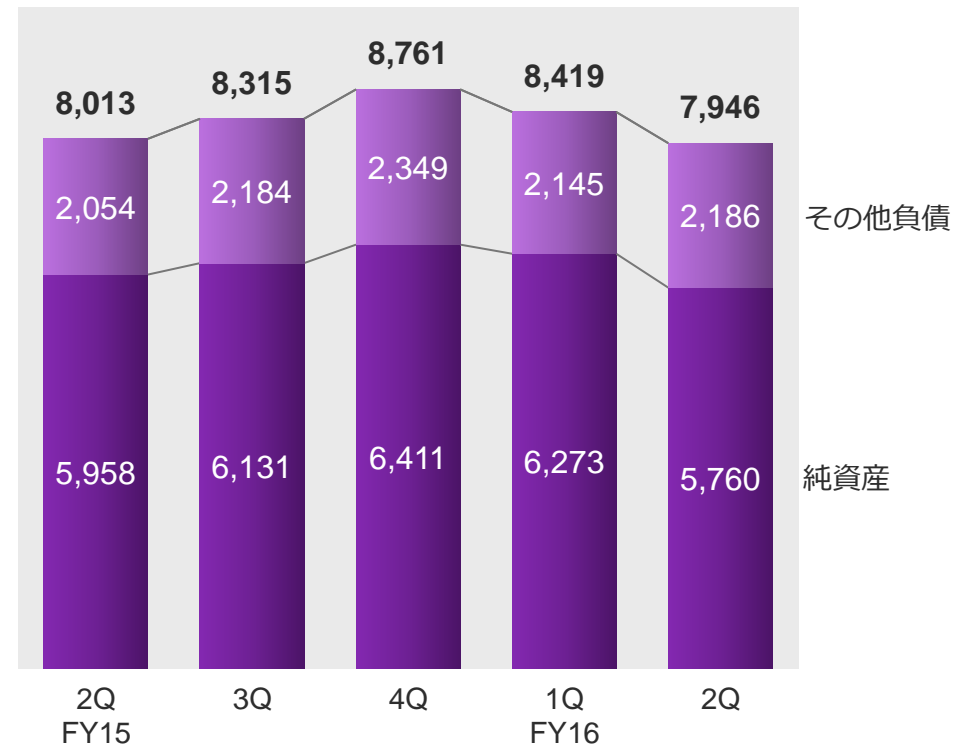
資産

(億円)



負債・純資産

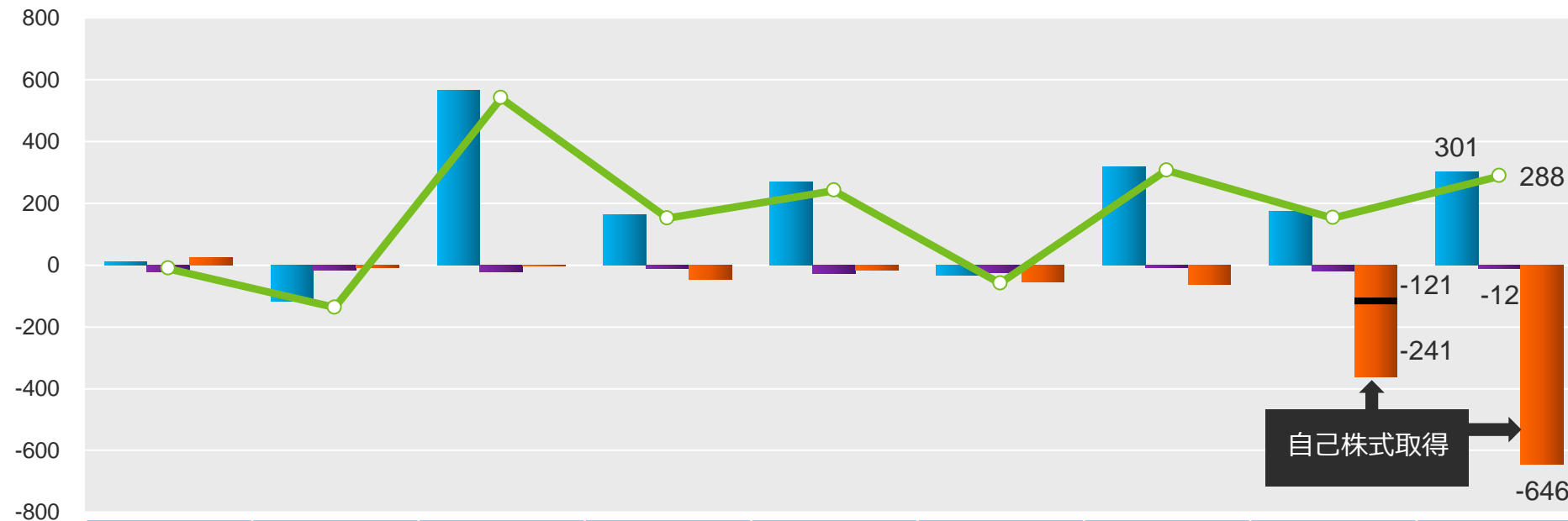
(億円)



*現金同等物：現預金＋短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

キャッシュ・フロー

(億円)



	2Q FY14	3Q	4Q	1Q FY15	2Q	3Q	4Q	1Q FY16	2Q
■ 営業キャッシュフロー	11	-118	565	164	268	-32	317	173	301
■ 投資キャッシュフロー*	-23	-18	-23	-12	-27	-26	-9	-20	-12
■ 財務キャッシュフロー	25	-8	-4	-46	-18	-54	-62	-363	-646
○ フリーキャッシュフロー**	-11	-137	541	152	241	-59	307	153	288
手元資金残高***	2,308	2,125	2,681	2,800	2,991	2,853	3,176	2,989	2,607

*投資キャッシュフローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

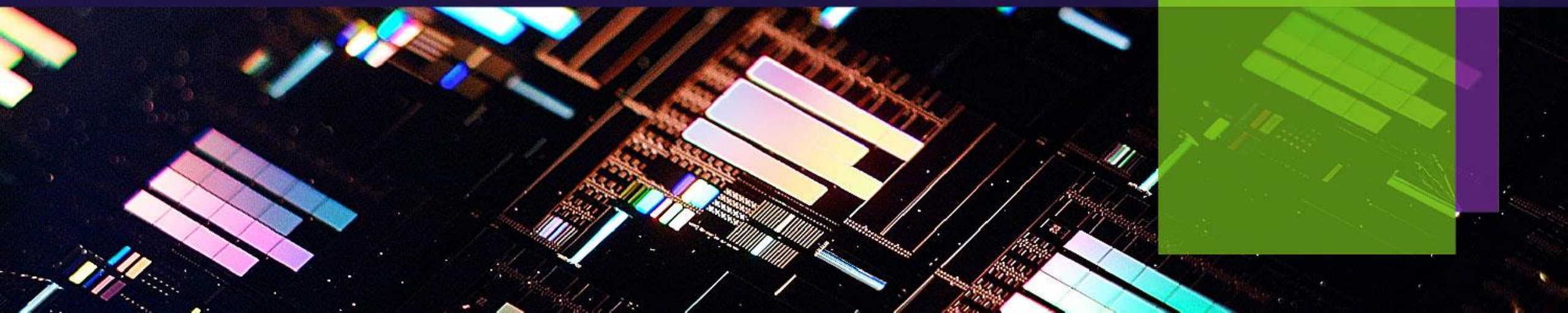
**フリーキャッシュフロー = 営業活動によるキャッシュフロー + 投資活動によるキャッシュフロー (満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く)

***手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

当期業績予想および中期経営計画達成に向けた取り組み

2015年10月27日

河合 利樹
代表取締役副社長、COO



事業環境

▶ 半導体設備投資

CY2015の半導体前工程（WFE）の設備投資額は、前年比同水準を見込む。

- メモリ：増産投資により前年比増加
- ファウンドリ：モバイル市場の減速により前年比減少
- ロジック：サーバ・イメージセンサ向けが好調である一方、PC需要が弱含み、ロジック全体としては前年比減少

▶ FPD設備投資

CY2015の液晶パネル用製造装置の需要は、大型パネル向け設備投資の増加に加えて、モバイル用途の中小型パネル向けの投資も開始され、前年比20%の増加を見込む。有機ELテレビ市場の立ち上がりは2017年以降。

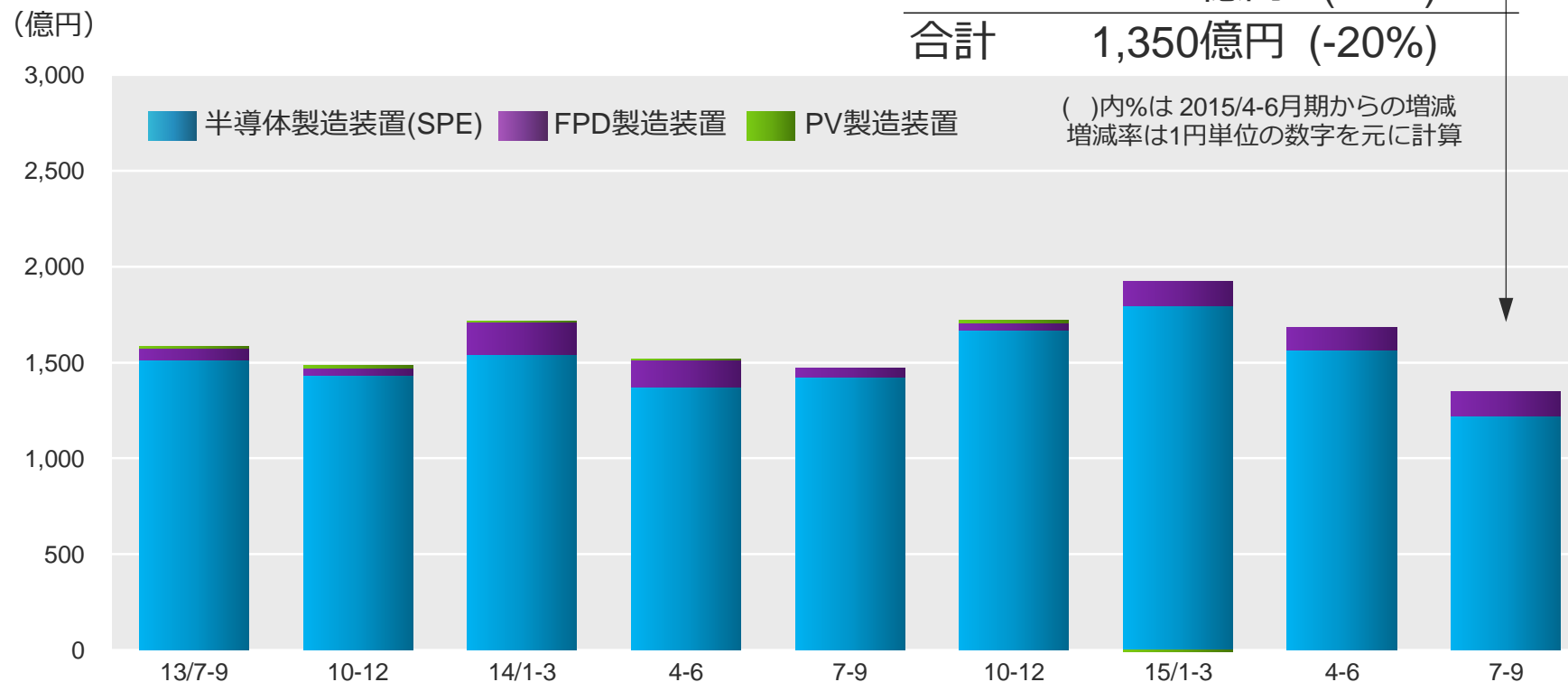
（2015年10月時点での見方）

半導体の製造工程には、ウェハー状態で回路形成・検査をする前工程と、チップごとに切断・組み立て・検査をする後工程があります。
WFE（Wafer Fab Equipment）は、この前工程で使用される製造装置を示します。

四半期 受注額

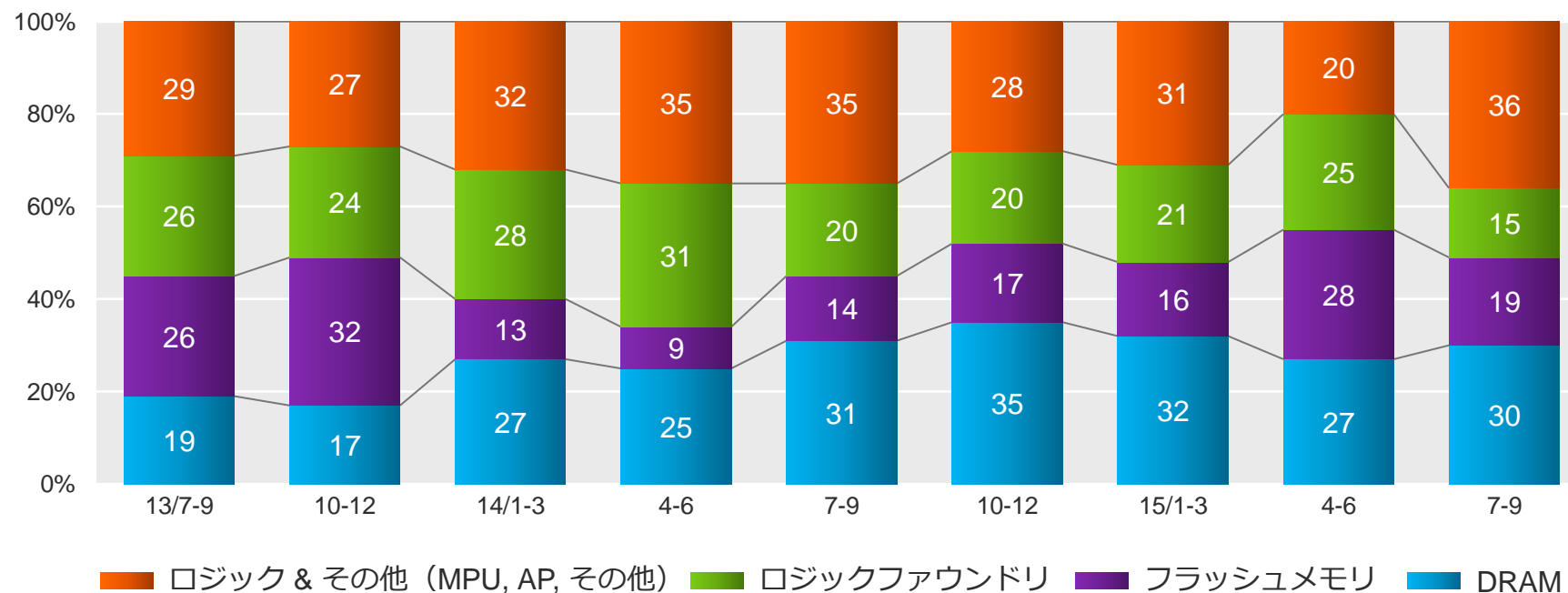
2015/7-9月期

SPE	1,224億円 (-22%)
FPD	125億円 (+6%)
合計	1,350億円 (-20%)



2015/4-6月期より、PV製造装置事業については、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に定める重要性を満たさなくなったため、報告セグメントから除外しました。
これにより、受注額についても非開示としています。

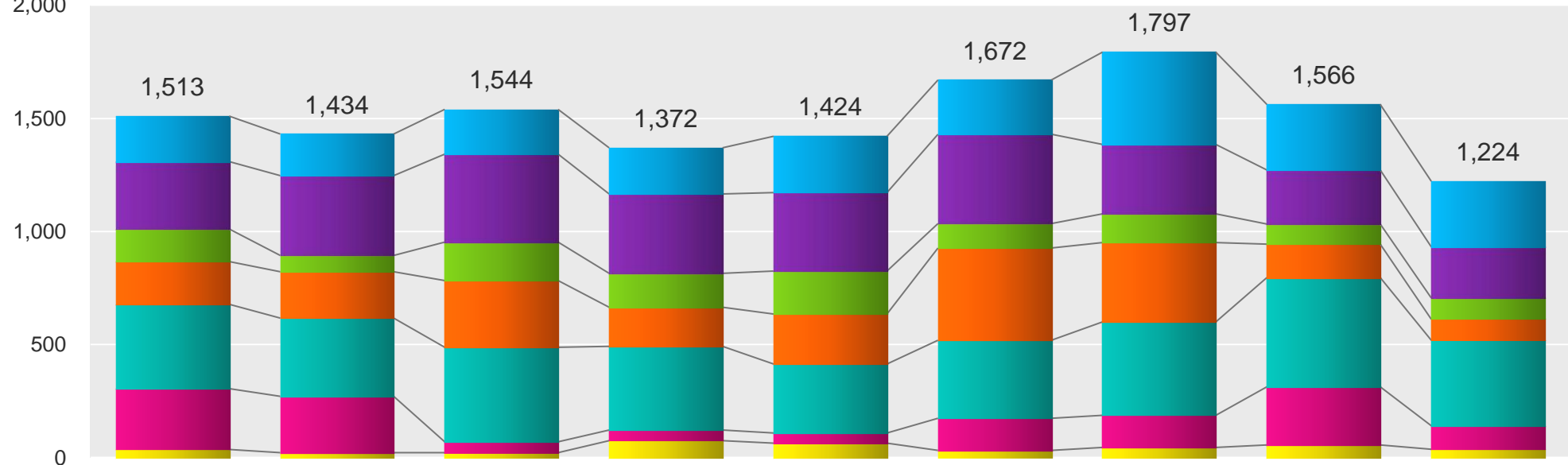
SPE受注アプリケーション別構成比



グラフは装置本体受注額における構成比を示しています。

地域別SPE受注額

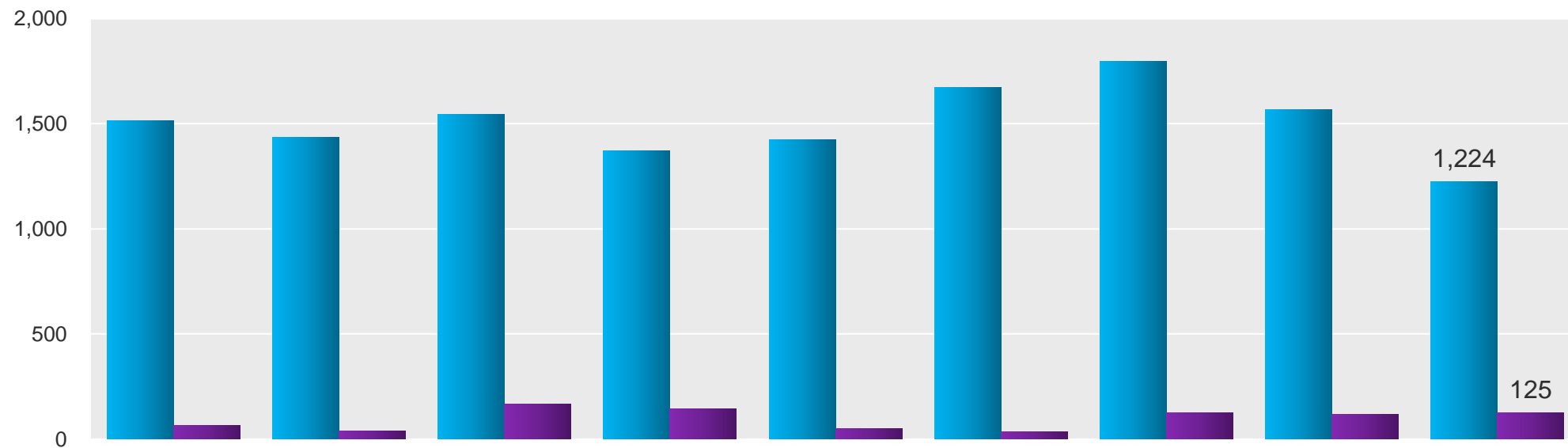
(億円)
2,000



	13/7-9	10-12	14/1-3	4-6	7-9	10-12	15/1-3	4-6	7-9
国内	201	184	198	204	249	240	408	290	290
米国	298	353	389	351	347	395	307	239	226
欧州	144	72	170	150	190	108	127	89	94
韓国	189	205	295	173	221	408	351	148	93
台湾	373	346	418	370	305	345	413	483	378
中国	269	249	48	47	45	142	142	257	104
東南アジア・他	36	22	22	75	64	32	45	56	37

受注額・受注残高

(億円)



	13/7-9	10-12	14/1-3	4-6	7-9	10-12	15/1-3	4-6	7-9
■ SPE受注額	1,513	1,434	1,544	1,372	1,424	1,672	1,797	1,566	1,224
■ FPD受注額	63	38	166	142	48	34	126	118	125
SPE受注残高	1,960	2,372	2,099	2,110	2,170	2,523	2,604	2,767	2,226
FPD受注残高	274	225	290	293	291	288	316	333	376

2015/4-6月期より、PV製造装置事業については、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に定める重要性を満たさなくなったため、報告セグメントから除外しました。これにより、受注額、受注残高についても非開示としています。

2016年3月期 業績予想修正

2016年3月期 業績予想修正

- 収益性が向上、通期営業利益1,000億円超、営業利益率16%を見込む

(億円)

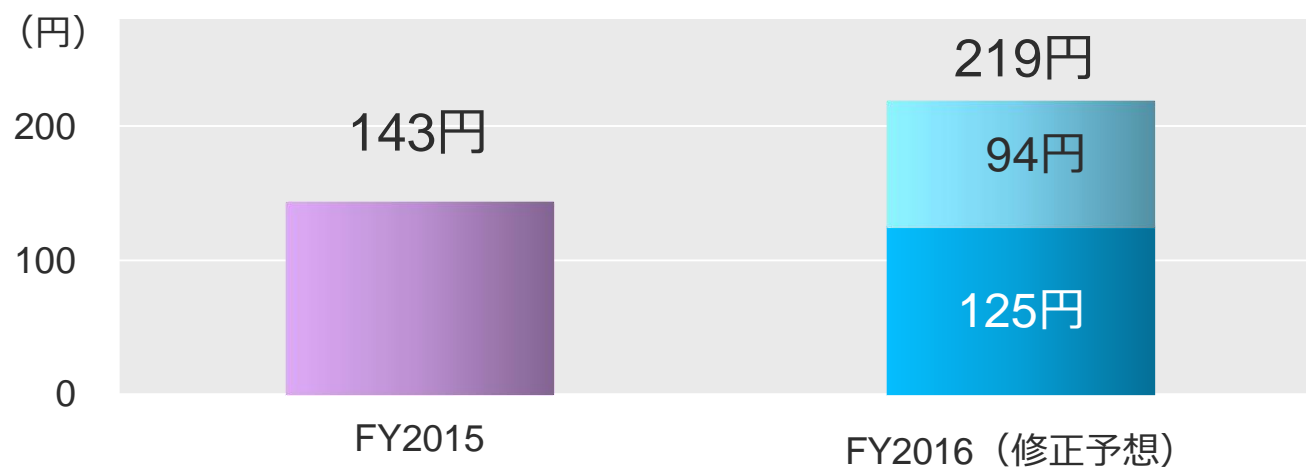
	FY2015 (実績)	FY2016 (予想)					
		上期	下期		通期		通期 対前年 増減
		実績	新予想	修正額*	新予想	修正額*	
売上高	6,131	3,409	3,191	+126	6,600	+150	+8%
SPE	5,762	3,169	2,931	+141	6,100	+160	+6%
FPD	327	182	258	-12	440	-10	+35%
営業利益	881	612	438	+23	1,050	+100	+168
下段：営業利益率	14.4%	18.0%	13.7%	+0.2pts	15.9%	+1.2pts	+1.5pts
税前利益	868	575	425	+10	1,000	+60	+131
親会社株主に帰属する 当期純利益	718	413	307	+17	720	+60	+1

*修正額：2015/7/28に発表した業績予想からの修正額を示しています。SPE: 半導体製造装置 FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置

2016年3月期 配当予想

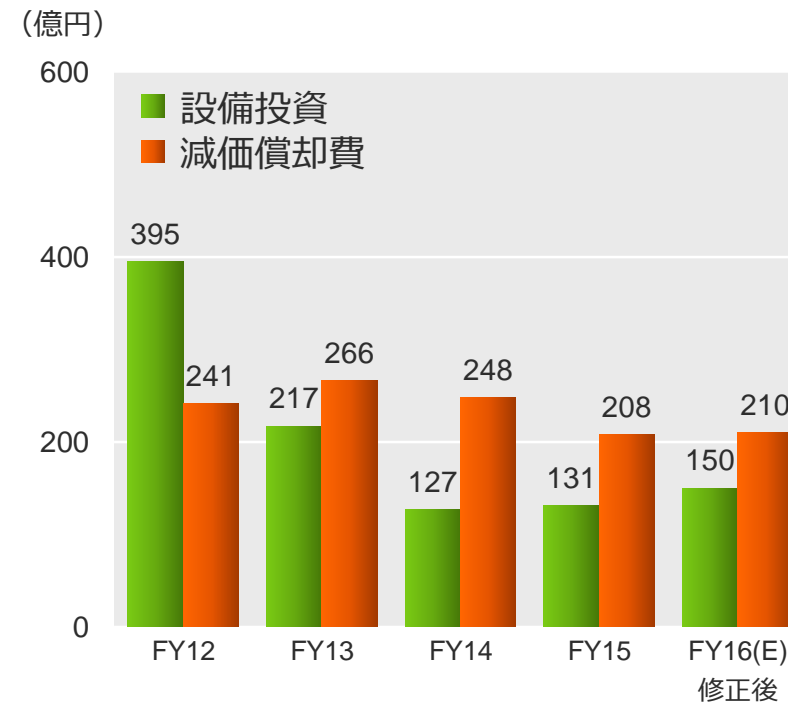
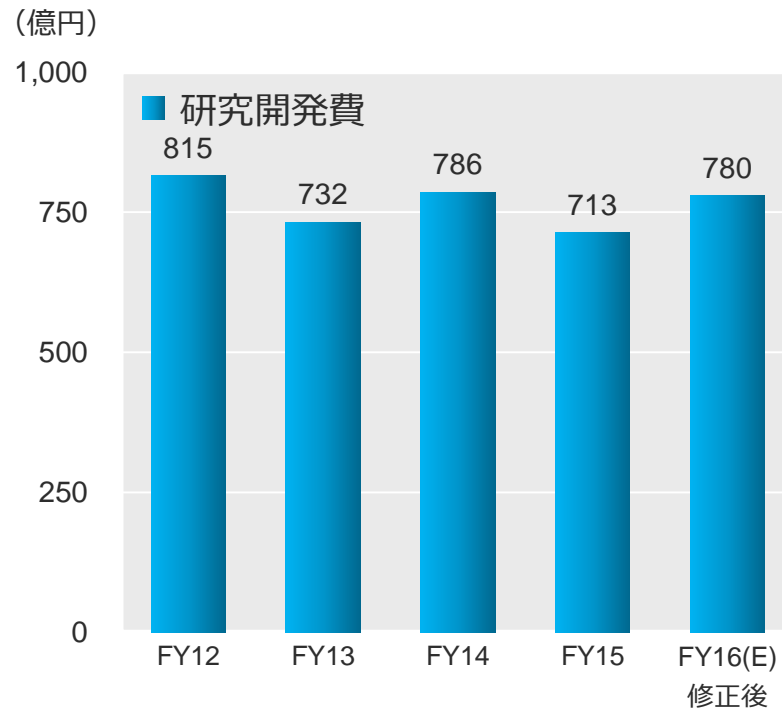
- 7月に発表した新株主還元策（配当性向50%）に基づき、219円の配当を予定

1株当たり配当金（予想）		
中間配当	期末配当	合計
125円	94円	219円



従来の配当政策は、FY2011の期末配当より連結配当性向を35%目途としておりました。

研究開発費・設備投資計画



研究開発費：740億円→780億円に修正
設備投資額：120億円→150億円に修正

中期経営計画達成に向けた取り組み

財務モデル（2020年3月期までに達成）

目指すのは、グローバル水準の収益力

(億円)

	2016年3月期 (予想)	2020年3月期 (中期計画)	
	WFE \$32B	WFE \$30B	WFE \$37B
売上高	6,600	7,200	9,000
売上総利益率	39%	42%	44%
販管費 売上高販管費比率	1,520 23%	1,600 22%	1,700 19%
営業利益率	16%	20%	25%
ROE		15%	20%

- 市場成長をアウトパフォーム
 - SPEの成長分野であるエッチング・成膜・洗浄事業に注力
 - フィールドソリューション事業の拡充
- オペレーションの効率化
 - 開発・製造の効率を高める
 - 売上高販管費比率の低減

半導体の製造工程には、ウェハー状態で回路形成・検査をする前工程と、チップごとに切断・組み立て・検査をする後工程があります。WFE (Wafer Fab Equipment) は、この前工程で使用される製造装置を示します。

SPE事業戦略 エッチング装置

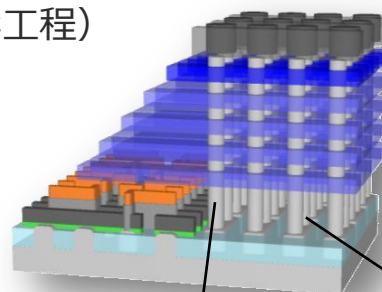
今後拡大するパターンニング工程とメモリ向けHARC工程でシェア向上を目指す

- 当社の強みであるHARC技術に磨きをかけ、圧倒的な生産性と加工精度により3D-NAND/DRAMの技術革新と生産性向上に寄与
- 先端パターンニング一括エッチングで顧客の生産コスト低減に大きく寄与

シェア計画

	CY2014 (実績)	CY2019 (計画)
エッチング装置	26%	>36%
酸化膜エッチ	62%	>70%
コンダクタエッチ	7%	>20%

3D-NAND
(HARC工程)

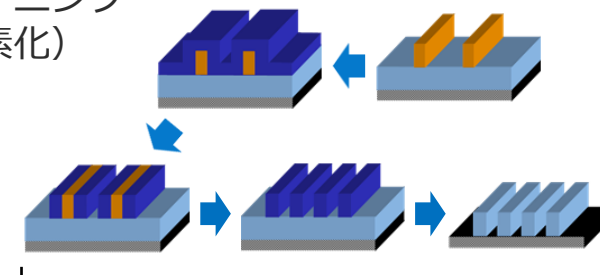


多層コンタクト

メモリホール

素子分離溝

先端パターンニング
(工程簡素化)



一括エッチング

HARC (High Aspect Ratio Contact) 工程：高度な加工技術を要する深穴形成工程

SPE事業戦略 熱処理成膜装置

今後需要が拡大するALD市場とDRAM向けでシェア向上を目指す

- ALD市場でリーディングポジションの確立。セミバッチALD装置NT333で、微細化・3D化で求められている高品質膜の形成と高生産性の両方を実現
- 次世代DRAM向けに圧倒的な生産性で差別化

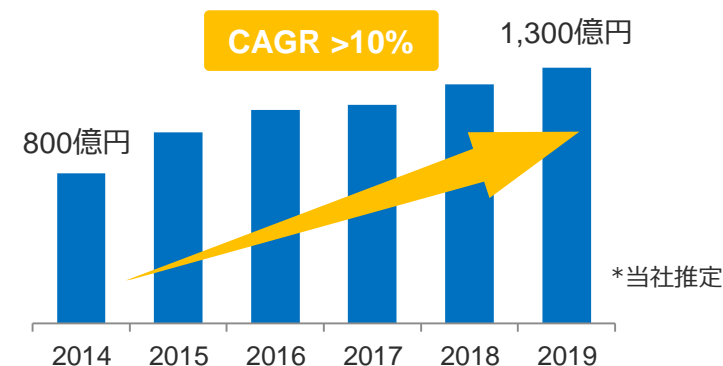
シェア計画

	CY2014 (実績)	CY2019 (計画)
熱処理成膜装置	55%	>65%



セミバッチALD成膜装置
NT333™

ALD成膜装置SAM*



*SAM: Served Available Market (製品対象市場)

SPE事業戦略 洗淨装置

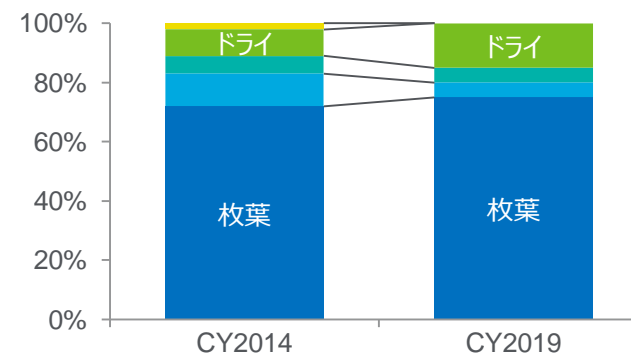
枚葉洗淨、ドライ洗淨において独自技術の適用工程拡大によりシェア向上を目指す

- 当社の強みであるパターン倒壊抑制技術、配線工程ポリマー除去/メタルロス低減、高精度裏面ベベル洗淨などにより、枚葉ウェット装置で歩留まり向上に寄与
- ドライ洗淨で高度な技術ニーズに対応

シェア計画

	CY2014 (実績)	CY2019 (計画)
洗淨装置	25%	>35%
ウェット	19%	>30%
ドライ	68%	>75%

洗淨装置市場構成比

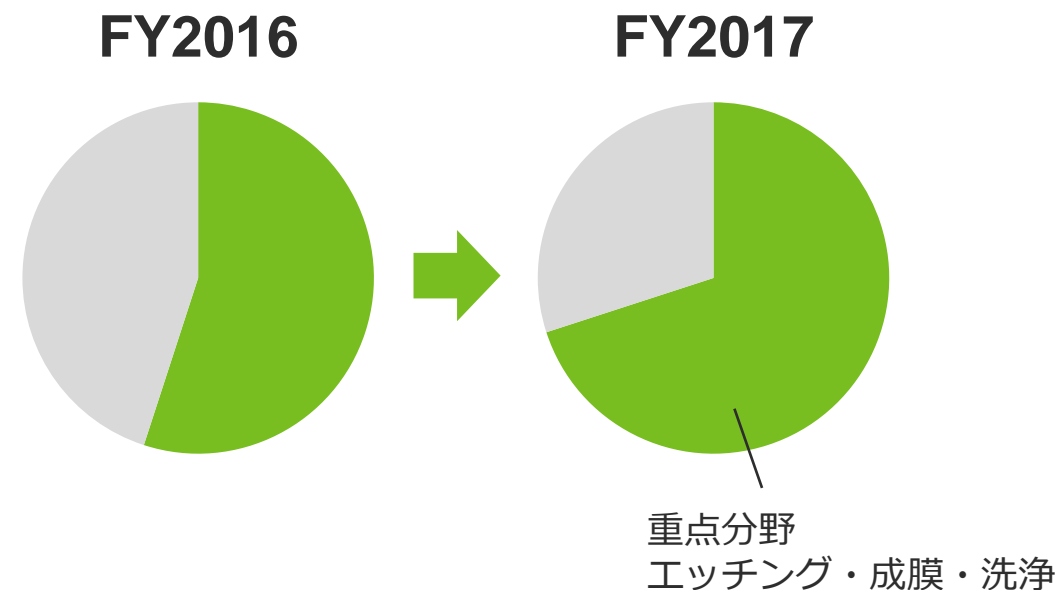


強いNext Generation Productの創出

COO直轄のもと、重点分野への開発強化

- 顧客開発とのダイレクトコンタクト
 - 次世代技術への提案とスピード
- 開発リソースの一元管理
 - BU横軸の開発組織
 - パターニングソリューションプロジェクト等
 - 戦略プロダクトにリソース分配
 - 重点分野に100億円規模の開発費を再分配

開発費構成比



新たな開発体制で次世代技術への提案力を強化

フィールドソリューション事業拡大への取り組み

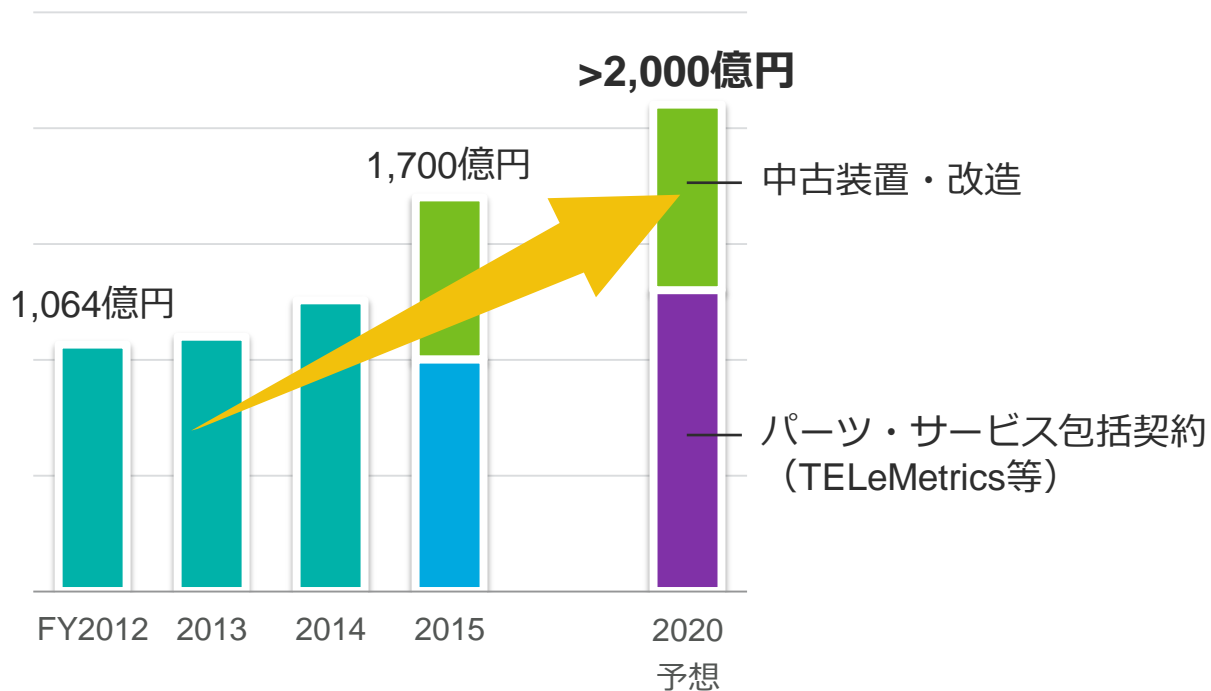
ビジネス機会の拡大

- IoTによる半導体需要の拡大
- 高度かつ多様になる技術ニーズ
- 当社57,000台の業界最大の納入済み製品台数

FS1部
中古装置・改造

FS2部
パーツ・サービス
包括契約
(TELeMetrics等)

フィールドソリューション売上高



中古装置とパーツサービス包括契約を主体に収益を最大化

フィールドソリューション事業拡大への取り組み

中古装置・改造

- IoTで拡大する200mm装置市場向けにメーカー認定中古装置を提供

パーツ・サービス包括契約

- 顧客の要望に見合うサービスパッケージを提案（包括契約）
 - 新たにTELeMetricsを提供
 - 顧客装置と当社サービスセンターをリモート接続し、装置の安定稼働を実現、顧客の生産性向上に寄与



LEAP: Life cycle Extension Availability Program

顧客の生産性向上をサポート、300億円以上の売上増加を見込む

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV：フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル

TEL™

TOKYO ELECTRON